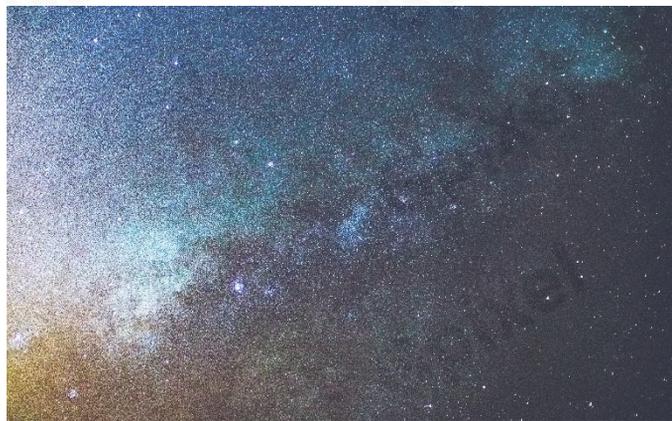


GSENSE6060BSI



37MP 科学级背照式CMOS图像传感器

GSENSE6060BSI是一款3700万分辨率、大靶面、科学级、背照式CMOS图像传感器。该芯片采用10 μm 像素尺寸、像素矩阵可进行双面读出，最高帧率为26 fps,芯片采用背照式加工工艺，其峰值量子效率高达95%,且感光谱段可拓展X光和紫外谱段。GSENSE6060BSI采用CMS技术，读出噪声仅为2.3 e^- ，在HDR模式下动态范围高达90 dB。GSENSE6060BSI采用氮化铝(ALN)PGA 陶瓷封装，其导热系数是传统氧化铝陶瓷封装的10倍，在深度制冷时也可保证感光面的平整度。



产品特性

- 大靶面
- 峰值量子效率：95%
- 动态范围：90 dB
- 片上12/14 bit ADC
- 片上温度传感器、SPI控制
- ALN 封装

应用领域

- 医疗
- 天文
- 高端科学成像
- X射线成像

产品指标

分辨率	6144 x 6144	Photo-sensitive area	61.44 mm × 61.44 mm
像素尺寸	10 μm × 10 μm	工作温度	-55°C~60°C
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	95% @ 580 nm
满阱容量	14 bit STD: 68 ke ⁻ @HG	动态范围	14 bit STD: 77 dB @HG
	12 bit STD:94 ke ⁻ @LG		12 bit STD:73 dB @LG
	12 bit HDR:95 ke ⁻		12 bit HDR:90 dB
读出噪声	14 bit STD: 2.3 e ⁻ @HG	最高帧率	14 bit STD: 8 fps
	12 bit STD:2.7 e ⁻ @HG		12 bit STD: 26 fps
	12 bit HDR:3 e ⁻		12 bit HDR:11 fps
输入时钟频率	35 MHz @ 12-bit	暗电流	0.019 e ⁻ /s/pix @ -53°C
	30 MHz @ 14-bit		
输出接口	50 对 of LVDS	最大数据率	21Gbps @12-bit
色彩	黑白	功耗	4.6 W
供电电压	6.5V 模拟	封装形式	250-pin PGA
	1.85V 数字		74 mmx99 mm

订购信息

产品编码

GSENSE6060BSI-ABM-NPN-AR0

黑白, 无微透镜, 250 pins PGA ALN封装, 无抗反射镀膜的带陶瓷环D263T可拆卸玻璃盖板,0级品。

GSENSE6060BSI-ABM-NPN-AR1

黑白, 无微透镜, 250 pins PGA ALN封装, 无抗反射镀膜的带陶瓷环D263T可拆卸玻璃盖板,1级品。

GSENSE6060BSI-ABM-NPN-AR2

黑白, 无微透镜, 250 pins PGA ALN封装, 无抗反射镀膜的带陶瓷环D263T可拆卸玻璃盖板,2级品。

评估板

EVA-6060B-RT12

操作模式: HDR、镜头卡口: T-mount、输出接口: Camera link MDR-MDR

联系方式

长光辰芯 (总部)

地址: 吉林省长春市经济技术开发区自由大路7691号, 光电信息产业园一期5号办公楼
电话: +86-0431-85077785

长光辰芯 (杭州子公司)

地址: 浙江省杭州市滨江区建业路599号华业发展中心31层3101-3109室
电话: +86-571-87718606-888

长光辰芯 (大连子公司)

地址: 辽宁省大连市高新技术产业园区汇贤园7号11层#05D室
电话: +86-0411-39937666



更多联系方式